

ZERO[®]-TSP300-K20导热软垫

TDS技术数据表

特点/好处

- 热传导率=2.0W/mk
- 超好的贴服性,低硬度
- 电气绝缘
- 优异的柔软度



典型应用:

- 光电产业(平板显示器, LCD-TV, TFT-LCD, 内置电源模块, 背光模组模块, LED照明设备)
- 电脑产业(笔记型计算机, 计算机外设相关设备, PC主机, 工作站, 网络服务器, PC服务器)
- 网络产业(交换机, 集线器, 网络卡, 调制解调器, 传输设备)
- 家电产业(饮水机, 电磁炉, 空调)
- 其他产业(半导体照明设备, 测试/控制医疗仪器, 电源模块)
- 新能源动力电池;

| 特性 PROPERTY | TSP300R-K20-G30 | TSP300R-K20-G45 | TSP300R-K20-G45+GL | 测试仪器 Test equipment | 测试方法 Test Method | |
|--|--|---|--|--------------------------|---------------------|------|
| 结构和成份 | 陶瓷填充硅橡胶 | 陶瓷填充硅橡胶 | 陶瓷填充硅橡胶 玻纤强化 | -- | -- | |
| 颜色Color | 灰 | 灰 | 灰 | 目测 | Visual | |
| 厚度Thickness (mm) | 1--10 | 1--10 | 1--10 | PEACOCK厚度规 | ASTM D374 | |
| 密度Density (g/cc) | 2.7±0.2 | 2.7±0.2 | 2.7±0.2 | BS-H电子天秤/卡尺 | ASTM D792 | |
| 硬度 Hardness Bulk Rubber (SHORE C)@6MM | 30±5 | 45±5 | 45±5 | LX-C硬度计 | ASTM D2240 | |
| 杨氏模量Young' s modulus (Psi) | 17 (@1MM) | 30 (@1MM) | N/A | KJ1065 (A) 电脑式拉压力试验机 | -- | |
| 抗张强度Tensile Strength (Psi) | 17 (@1MM) | 35 (@1MM) | N/A | KJ1065 (A) 电脑式拉压力试验机 | ASTM D412 | |
| 延伸率 Elongation (%) | 130 (@1MM) | 100 (@1MM) | N/A | KJ1065 (A) 电脑式拉压力试验机 | ASTM D412 | |
| 导热系数Thermal Conductivity (W/M.K) @3MM | 2.0±0.2 | 2.0±0.2 | 2.0±0.2 | DRL-III 导热系数测试仪 | ASTM D5470 | |
| 热阻Thermal Resistance (°C · in ² /W) | 0.6@1MM 1.0@2MM 1.4@3MM 1.7@4MM 2.1@5MM 2.4@6MM | 0.65@1MM 1.12@2MM 1.43@3MM 1.7@4MM 2.18@5MM 2.52@6MM | 0.7@1MM 1.1@2MM 1.6@3MM 1.8@4MM 2.2@5MM 2.3@6MM | DRL-III 导热系数测试仪 | ASTM D5470 | |
| 击穿电压Breakdown Voltage (KV/AC) | ≧6 (@1MM) | ≧6 (@1MM) | ≧6 (@1MM) | BDJC-50KV 电压击穿试验机 | ASTM D149 | |
| 介电常数Dielectric Constant (1000Hz) | 3.8 (@2MM) | 3.8 (@2MM) | 3.6 (@2MM) | WY2851D数显Q表 | ASTM D150 | |
| 体积电阻Volume Resistivity (Ohm-meter) | 10 ¹⁴ (@1MM) | 10 ¹⁴ (@1MM) | 10 ¹⁴ (@1MM) | BEST-212智能表面 体积电阻率测试仪 | ASTM D257 | |
| 防火等级 Flame Rating | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | E464456 | UL | |
| ROHS & REACH | OK | OK | OK | -- | CTI TEST | |
| 耐温Continuous Use Temp (°C) | -40to150 | -40to150 | -40to150 | -- | -- | |
| 热阻特性VS压力 (厚度为1MM样片为参考) | | | | | | |
| 压力Pressure (psi) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 热阻Thermal Resistance (°C · in ² /W) | 0.74 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |
| 压缩比例Compression ratio (%) | 5% | 14% | 25% | 49% | 61% | 68% |
| 保持期 (1年) Retention period | 阴暗条件储存, 温度≤40° C, 湿度≤70% 堆放不超过7层, 总高度低于1米 | | | | | |



以上数据由零度导热实验室提供, 该实验室保留最终解释权。